

「JISSO PROTEC 2020」特設サイト

2020年5月27日(水)から29日(金)まで東京ビッグサイトで開催予定の「JISSO PROTEC 2020」は、新型コロナウイルスの影響により、開催中止となりました。

本サイトでは、「JISSO PROTEC 2020」に出展予定だったタムラ製作所の最新の製品や技術をご案内いたします。



【タムラ製作所の車載向け製品群】

次世代のモビリティ環境に向けたタムラグループの車載事業展開
Tamura group's automotive business development toward next generation mobility environment

Reliability	Quality	Connected	Design	Power
 高耐熱Pbフリー合金 High heat resistance Pb-free solder alloy	 耐フラックス残さ亀裂 ソルダーペースト Crack-free residue solder paste	 水溶性プリフラックス OSP	 白色反射材 White reflective material for FPC	 車載用リアクタ Peacator for automotive
 高信頼性 ソルダーレジスト High reliability solder resist	 リフロー装置 Pulse flow soldering systems	 PKG用ソルダーペースト Solder paste for bump formation	 黒色吸収材 Black absorbing materials	
			 FPC用ソルダーレジスト Solder resist for FPC	

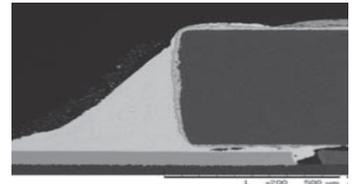
電気自動車、ハイブリッド/プラグインハイブリッド自動車などエコカーのニーズが世界的に高まり、車社会の主流となりつつあります。タムラはエコカーの燃費・環境性能をはじめ、走行性能や加速性能を高めるために欠かせない幅広い車載関連製品を提供。そのさらなる進化に挑むとともに生産体制も拡充、エコカーの性能向上や本格的な普及を、タムラの卓越した技術力で支えています。

【出展製品】

■ 接合材料

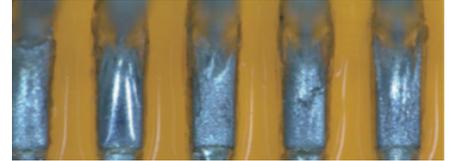
・高耐熱Pbフリー合金「#287」

HV、EV化に伴いECU/PCUでは、より一層厳しいヒートサイクル基準が求められます。従来の車載市場で長い実績を有するSAC305では、 $-40\Rightarrow 125^{\circ}\text{C}/3000\text{Cycles}$ の要求に応えるには限界が来ております。弊社が新規開発した合金組成を使用することで、 $-40\Rightarrow 125^{\circ}\text{C}/3000\text{Cycles}$ にてSAC305比較ではんだ接合部に発生する亀裂進展を大幅に抑制することが可能になりました。



・高耐熱高信頼性 solder パステ 「TLF-204-203」

マイグレーション発生原因となりえるフラックス残さ中の亀裂を抑制した従来品から、更に、ポイド発生率、印刷安定性など諸特性のレベルアップを図りました。また、基板実装効率化のため車載機器分野でも導入が進んでいるスルーホールリフロー工法にも対応し、効率かつ高品質な基板実装が可能です。



・ジェット対応Pbフリー solder パステ 「JDSシリーズ」

既存の印刷工法では位置合わせの難しいFPC基板、印刷難度の高いキャビティを有する基板、立体的な基板のはんだ付といった用途において、非接触のはんだ塗布としてジェットディスプレイ工法の適用が検討されています。「JDSシリーズ」は、塗布径に合わせてSAC305で2種の solder パステを製品化し、ジェットディスプレイにおける吐出安定性と飛び散り(サテライト)低減に対応しています。



■ 絶縁材料

・車載機器用 高耐熱高信頼 solder レジスト 「DSR-2200ACRシリーズ」

次世代車載基板に要求される過酷環境下での耐塗膜クラック性、耐熱性、絶縁信頼性、密着性等の長期信頼性に優れた高機能 solder レジストです。ハロゲンフリー。セミマットタイプ有り。



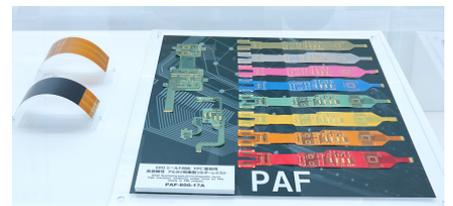
・高耐熱写真現像型 solder レジスト フレキシブル基板用 白色反射材 「RPW-300シリーズ」

先進樹脂設計技術により優れた折り曲げ性能、高反射率、高解像性、低露光量を実現した白色 solder レジストです。Mini LEDバックライト基板などの次世代ディスプレイ用途や高意匠性車載LED用途に適しております。



・フレキシブル基板用写真現像型 高耐熱高絶縁信頼性 solder レジスト 「PAF-800シリーズ」「TPL-800シリーズ」

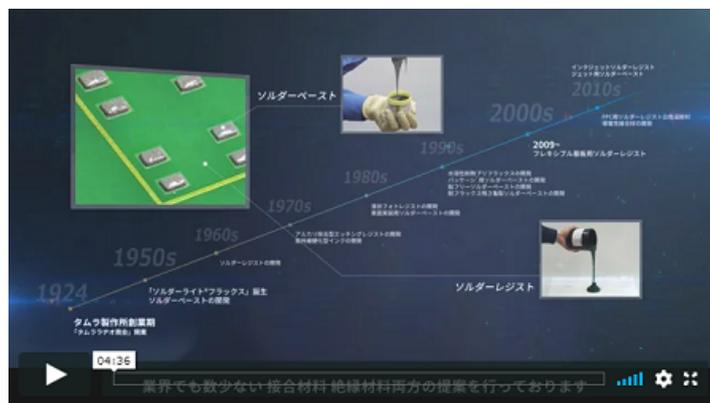
優れた柔軟性と高絶縁信頼性を持ち合わせたフレキシブル基板向け solder レジストです。EMIシールドフィルムの貼り付けが可能であり、部品実装部と配線部への solder レジストの一括形成を提案いたします。一括形成による製造工程の削減、並びにベゼルレスディスプレイに要求される基板の薄膜化や組込み時の形状保持(低反発特性)を実現します。液状とドライフィルムを取り揃えております。



【製品カタログPDFダウンロード】

- [電子化学材料カタログ](#) ( PDF 6.1MB)

【電子化学紹介動画】



【お問い合わせ・資料請求】

- [お問い合わせフォーム](#)

■ 実装装置

・こんな時こそ、メンテナンスサイクルを大幅見直しできる新型リフロー
「TNV Version III」

日々、設備投資が厳しくなっている状況かと思いますが、こんな時こそメンテナンスサイクルを大幅見直しできる新型リフローを、次期投資にご検討されませんか。

実装設備は、炉内の汚れを大幅に低減し、飛躍的にメンテナンスサイクルの延長・改善を実現するTNV Version IIIを出展いたします。最新の革新技術により、生産機会損失を大幅に低減します。



【製品パネルデータPDFダウンロード】

- [リフロー TNV Version III \(PDF 468KB\)](#)
- [ツインチャンバー デュアルレーンリフロー装置 \(PDF 280KB\)](#)
- [シングルチャンバー デュアルレーンリフロー装置 \(PDF 208KB\)](#)
- [メンテナンスパック \(PDF 299KB\)](#)

【リフロー TNV Version III 紹介動画】



【お問い合わせ・資料請求】

- [お問い合わせフォーム](#)

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社タムラ製作所 経営管理本部 経営支援グループ